



新闻稿

2011年9月5日

Microsemi 宣布提供 SmartFusion cSoC 成本优化版本

高成本效益解决方案是工业、通信、医疗和军事/航天领域应用的理想选择

致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司 (Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号: MSCC) 宣布提供经成本优化的 SmartFusion[®]可定制单芯片系统 (customizable system-on-chip, cSoC) 器件 A2F060, 该器件备有商用和工业温度等级型款, 专门针对大批量应用而设计, 包括马达和运动控制、游戏机、太阳能逆变器, 以及临床和成像医疗电子设备。

美高森美 SoC 产品部陆地产品副总裁 Rich Kapusta 表示: “我们通过扩大获奖的 SmartFusion 产品系列, 在维持核心功能之余, 还能够满足嵌入式系统广泛的性能和成本需求。客户能够在高集成度 SmartFusion 平台上实现标准化, 这可让他们提供从低端至高端系统的广泛产品, 而无需牺牲性能。”

Microsemi cSoC 产品组合的最新成员 A2F060 具有 6 万个系统门, 一个带有 128 Kbytes 嵌入式闪存和 16Kbytes 嵌入式 SRAM 并基于 100 MHz 32 位 ARM[®] Cortex[™]-M3 硬核处理器的微控制器子系统, 以及包含一个 ADC、一个 DAC 和两个比较器的可编程模拟资源。其它主要特性包括:

微控制器子系统

- 100 MHz, 125 DMIPS 数据吞吐量, 带有 128 Kbytes 闪存和 16 Kbytes SRAM
- 专用外部存储器控制器, 每个器件具有两个: SPI、UART、32 位定时器

可编程模拟资源

- 一个具有多达 11 个通道和 500 Ksps 采样速率的 12 位 SAR 模数转换器；包括 8/10 位模式和采样保持功能
- 一个具有 500 Ksps 更新速率的 12 位 sigma-delta 数模转换器
- 两个时钟调节电路(CCC)和一个具有相位移动、乘/除，以及延迟功能的集成式模拟 PLL，以及 1.5 至 350 MHz 的输入频率范围
- 两个双极高压监控器 (具有 +/-2.5 V 至 -11.5/+14 V 的四个输入电压范围)，精度为 1%

FPGA 架构

- 350 MHz 系统性能，6 万个系统门和 36 Kbytes SRAM
- 使用高速 FPGA I/O 和系统门来创建额外的标准接口或专有接口
- 多达 107 个用户 I/O，包括 FPGA、微控制器 GPIO 和模拟 I/O

Microsemi SmartFusion cSoC 是唯一集成有 FPGA、围绕硬核 ARM Cortex-M3 处理器构建的完整微控制器子系统和可编程模拟资源的器件，能够实现完全定制、IP 保护和易用性优势。SmartFusion 器件基于美高森美的专有快闪工艺，是需要高集成度 SoC 器件的硬件和嵌入式产品设计人员的理想选择，在提供较传统固定功能微控制器更高的灵活性之余，更大幅降低了传统 FPGA 上软处理器内核的成本。

价格和供货

Microsemi SmartFusion A2F060 器件采用 FG256 和 CS288 有铅及无铅 ROHS 兼容封装，美高森美提供基于该产品系列的较大型器件的开发工具套件和评测工具套件，以实现快速构建原型平台。基于 A2F200 器件的评测工具套件(A2F-EVAL-KIT)的价格为 99 美元，基于 A2F500 器件的开发工具套件(A2F500-DEV-KIT)的价格为 999 美元。

关于美高森美公司

美高森美公司(Microsemi Corporation，纽约纳斯达克交易所代号：MSCC)为航天、国防与安全、企业与商业，以及工业与替代能源市场提供业界综合性的半导体解决方案系列，包括高性能及高可靠性模拟与射频器件、混合信号与射频集成电路、可定制系统单芯片

(SoC)、FPGA，以及完整的子系统。美高森美总部设于美国加利福尼亚州 Aliso Viejo，全球员工总数超过 2,700 人。欲获取更详尽信息，请访问网站：<http://www.microsemi.com>。

发稿：美高森美公司

代发：隽科公关有限公司

媒体垂询，请联络：

美高森美公司

刘怡君

电话：(886) 2 2656 0056 # 18

电邮：regine.liu@microsemi.com

隽科公关

陈家丽/李家慧

电话：(010) 6410 8528

电邮：ailie@techworksasia.com /

karrie@techworksasia.com

Microsemi 与公司标志，以及其它商标均是美高森美公司与/或其附属公司的商标或注册商标。所有其它商标及服务标志属有关拥有者所有。

以下为依照美国私人证券法 1995 年修订案规定而发出的“安全规避”声明：本文中所有还不是历史事实的声明均为“前瞻性声明”，这些“前瞻性声明”可能涉及风险，不确定性和假设，而实际的结果或成果也可能与这些前瞻性声明的预计结果出现重大的差异。具体的前瞻性声明包括提供经成本优化的 SmartFusion® 可定制单芯片系统 (customizable system-on-chip, cSoC) 器件，以及其对未来业务的潜在影响的陈述。其中，下列因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所描述的结果存在实质性的差异：技术的快速变化或产品停产；潜在成本上涨；客户订单偏好的改变；半导体行业的激烈竞争以及随之而来的价格下滑压力，对产品的需求与接受程度相关的不确定因素；终端市场的不利条件；正在进行中或已计划的发展或市场推广和宣传所带来的影响，预测未来需求的困难性；预期订单或积压订单无法实现的可能性；产品责任问题，以及现有或预计半导体行业出现其它未能预计的潜在业务和经济情况或不利因素；保护专利及其它所有权的困难性和成本，客户的产品认证事宜而引致产品停产或其它困难等。美高森美将在未来不定期提交附加的风险因素。除这些因素和在本新闻稿的其他部分所提到的其他因素外，读者还应参阅由美高森美向美国证券交易委员会备案的公司最新 10-K 表格及所有后续的 10-Q 报告中所述的因素，不确定性或风险。本新闻稿所含的前瞻性陈述仅叙述截至本稿刊发之日的情形，并且美高森美概不承担对这些前瞻性陈述进行更新以反映后续事件或情况的义务。